

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2026 年 8 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生；财务总监、副总经理金良凯先生；董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2026 年上半年公司整体经营情况？ 2026 年上半年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下延续增长态势。美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2026 年第一季度全球半导体销售额达到 2,985 亿美元，创季度历史新高。从细分领域来看，行业整体发展出现结构性分化，呈现出 AI 相关需求高速增长、传统应用领域平稳复苏的格局。一方面，在人工智能、高性能计算等领域对 CPU、GPU、HBM 等集成电路产品的强劲需求的推动下，高性能逻辑芯片和高端存储器需求爆发式增长，总体呈现供不应求的格局。另一方面，传统应用领域包括消费电子、部分工业与汽车电子受整体消费需求、宏观经济环境、AI 需求挤压等因素影响，呈现缓慢复苏状态，但随着大模型能力的持续提升及端侧 AI 产品的逐步落地，未来仍将存在巨大发展空间。

	2026 年上半年,公司实现营业收入 241,141.43 万元,同比增长 19.95%; 实现归属于母公司所有者的净利润 3,936.07 万元,较上年同期增长 29.82%。自公司二期项目启动以来,公司营收增长与盈利能力持续向好,规模效应逐步体现,目前营业规模已经初步跨过盈亏平衡点,主营业务盈利能力持续增强。 产品结构方面, QFN 产品实现收入 95,858.64 万元,同比增长 26.18%, 收入占比为 40.49%; SiP 产品实现收入 91,762.84 万元,同比增长 10.89%,收入占比为 38.76%; FC 产品实现收入 35,962.79 万元, 同比增长 21.93%, 占比为 15.19%; 晶圆级产品实现收入 11,107.09 万元,同比增长 30.24%, 占比提高至 4.69%。 下游应用方面,公司核心 AIoT 客户群基本盘保持稳定。2026 年上半年, AIoT 业务收入同比增长接近 20%, 占比 60%左右; 安防业务收入同比增长超过 30%, 其他领域业务相对保持平稳。 客户拓展方面,受地缘环境影响,全球龙头设计公司基于 China for China 等多方面战略考量,在海外产能紧缺的情况下,在中国大陆进行产能布局的意愿明显提升,公司抢抓战略机遇,在深耕中国台湾地区客户的基础上,积极拓展欧美客户群体,与多家头部车规芯片、电源管理芯片厂商建立合作关系,新产品稳步放量中。2026 年上半年, 公司海外客户营收同比增长 8.21%, 占比达到 23.21%。此外, 公司现有核心 AIoT 客户群基本盘稳固, 已成为多家 SoC 客户的核心供应商。2026 年上半年, 公司共有 11 家客户销售额超过 5,000 万元, 客户结构进一步优化, 为持续发展奠定坚实基础。 期间费用方面, 公司规模效应进一步显现。2026 年上半年, 公司销售、管理、研发及财务费用合计 42,920.73
--	--

	万元，期间费用率为 17.80%，同比下降 2.00 个百分点。其中，管理费用率为 5.82%，同比下降 0.79 个百分点；财务费用率为 4.23%，同比下降 0.92 个百分点；研发费用为 16,053.93 万元，研发费用率为 6.66%。公司在费用率逐步下降的同时，继续保持较高强度的研发投入，为先进封装产品研发和客户项目导入提供支持。 研发投入方面，2026 年上半年公司研发投入金额达到 16,053.93 万元，占营业收入的比例为 6.66%，同比增长 12.91%。公司先进封装产品线客户群稳步扩大，通过实施 Bumping 项目已掌握 RDL 及凸点加工能力，并积极布局扇出式封装（Fan-out）及 2.5D/3D 封装工艺，Fan-out 结构的 RWLP 产品线实现量产，基于硅转接板和硅桥方案的 2.5D 产品均实现客户送样，目前正在与多家客户进行产品验证。公司自身技术水平和客户服务能力得到显著提升。 资本开支方面，上半年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 15.06 亿元，全年资本开支预计 40 亿元。 展望 2026 年下半年，人工智能等相关领域仍将保持快速增长，大模型能力的持续提升使得应用场景将进一步拓展，Token 调用量持续攀升，头部大模型公司 ARR 已超过百亿美金。根据 SIA、Omdia 等机构发布的预测数据，2026 年全球半导体行业销售额将达到或超过 1 万亿美元。公司将继续围绕增长目标，一方面继续坚持大客户战略，在深化原有客户群合作的基础上，积极推动与全球龙头设计公司的进一步合作，不断提升自身竞争力和市场份额；另一方面，公司将扎实稳健推进 Bumping、晶圆级封装、FC-BGA、2.5D/3D 等先进封装产品线，持续提升自身工艺能力和客户服务能力。
--	--

	2、行业稼动率较满且多家公司正在涨价，公司调价情况如何？对下半年毛利率如何展望？ 当前封测行业整体需求仍较紧张，公司产线稼动率维持高位。公司 2026 年以来已经进行过多轮价格上修，最新一轮调价将在第三季度前后陆续执行，随着调价落地、核心客户上量和规模效应显现，公司盈利能力将会得到提升。 3、从不同下游应用和不同封装工艺看，第三季度景气度及稼动率相较第二季度将如何变化？ 从下游应用看，AIoT 整体景气度仍相对较好，WiFi、蓝牙等客户需求保持平稳增长；安防客户景气度维持较高水平；中低端手机受存储涨价影响较大。 从封装工艺看，QFN 是公司当前交期最紧张、需求最旺盛的产品线之一。QFN 应用领域广泛，也是公司 AIoT 客户采用较多的封装形式，预计仍将保持较快增长。FC 封装产品线正处于大客户上量阶段，随着时间推进，相关需求和稼动率预计逐步改善。 4、公司在 2.5D 先进封装业务进展如何？对下半年及 2027 年如何展望？ 公司 2.5D 先进封装业务方面，与此前相比，参与验证和建立合作关系的客户数量进一步增加，客户群正在持续扩大。 后续量产节奏一方面取决于公司自身封装工艺验证，另一方面也取决于晶圆、关键材料及其他配套环节是否同步就绪。 5、公司对未来海外客户营收的展望？ 当前海外客户受封装产能紧缺影响，向中国大陆转移订单和布局产能的趋势正在加快，预计未来一段时间
--	--

	海外客户收入增速将高于公司整体收入增速，海外业务占比仍将持续提升。 6、公司此前公告的 103 亿元三期投资规划，具体将投向哪些扩产类别和方向？ 公司三期项目规划总投资 103 亿元，是继二期项目之后的中期产能建设安排。三期新增投资主要有两个方向：第一，扩充现有成熟产品线产能，以承接海外大客户导入后相对明确的产能需求；第二，重点投入晶圆级封装、2.5D 先进封装以及其他高阶产品线。相比现有产品线扩产，先进封装将占据更大的投资比重。 7、公司各主要产品线当前的稼动率情况如何？下半年分别如何展望？ QFN 是当前景气度最高、需求最旺盛的产品线之一，产品交期持续拉长，稼动率处于满产状态。SiP 产品线的稼动率也处于较高水平。晶圆级封装处于持续扩产阶段，稼动率处于爬坡期，公司已储备数家大客户并积极推进导入。FC 产品线与晶圆级封装的多项业务具有配套关系，随着晶圆级客户和其他大客户导入，FC 产线稼动率预计后续将逐步提升。 8、公司在光通信 NPO、CPO 封装方面是否已有项目进展？公司哪些封装技术可以用于光通信封装？现有产能是否可以复用？ 公司在与部分光通信领域客户进行初期项目对接和样品打样，但目前尚无量产时间表。 公司已布局的部分 Bumping、Fan-out 和 2.5D 先进封装技术可应用于光通信相关封装领域，部分产能能够复用。 9、第二季度部分材料涨价，目前公司材料供给是否受限？封装材料国产化情况如何？
--	---

	公司整体材料供应目前未受到实质性限制，但部分环节供应相对紧张，尤其是高端耗材以及与 AI 产品共用产能的材料，产能偏紧、交期有所拉长。 半导体封装材料种类较多，不同环节的国产化率差异较大。成熟主材的国产化率相对较高，高端材料的国产化率有待提高。公司将在兼顾材料性能、稳定性、客户认证及良率要求的前提下持续推进供应链国产化。 10、新增产线所需设备的交期如何？设备国产化率处于什么水平？ 设备交期整体正在拉长，部分供应紧缺设备的交期可能超过一年。设备国产化方面，先进封装黄光区的光刻、涂胶显影以及 CMP 等设备，国内厂商已经取得较好进展，其他高端环节仍需结合设备能力、工艺稳定性和量产验证情况逐步导入。 11、公司未来几年的资本开支节奏展望？ 公司 2026 年全年资本开支计划约 40 亿元。结合三期 103 亿元投资规划，预计未来 3-5 年的中期维度仍将保持较高资本开支强度。 资本开支由两类需求共同驱动：第一，AI 占用大量封装产能，海外友商将部分成熟产能转向先进封装，海外龙头客户的成熟产品需求向中国大陆外溢，公司需要扩充现有产品线承接相应需求；第二，先进封装需求较为明确，公司将持续加大晶圆级封装、Fan-out、2.5D 等产品线投入。 12、公司如何看国内封装需求、海外订单向国内转移以及国内客户需求增长的空间？行业大规模扩产先进封装是否存在产能过剩风险？ 封装需求本质上取决于半导体整体需求。过去半导体需求更多随消费电子库存周期波动，而本轮增长更多
--	---

	由 AI 创新周期驱动。随着大模型能力提升、token 调用量增加及端侧 AI 落地，算力需求仍将持续上升，进而带动芯片和封装需求。 短期来看，最直接的增长动力是海外订单外溢。AI 需求占用了大量先进封装产能，部分海外友商将资源转向先进封装，成熟产品产能供应收缩，海外龙头客户相应需求向中国大陆转移。第二个驱动力是 AI 本身及其配套芯片需求。除直接用于算力的芯片外，电源管理芯片等配套产品需求亦快速增长，公司正在导入相关大客户。第三个驱动力是国产算力及 2.5D 先进封装。公司相关布局主要服务国产算力。国内 CSP 厂商需求明确，一旦晶圆、封装和配套供应链瓶颈逐步解决，将形成较大增长空间。从更长期看，端侧 AI 应用场景也将持续拓展。所以综合以上几个角度来看，不管是在一个近期 1 到 2 年的维度，还是更长的中期维度，都能看到不同环节的增长驱动因素，所以公司对于未来封测市场空间较为乐观。 关于先进封装产能方面，当前行业仍处于供不应求状态，需求持续增长，关键在于未来供给与需求扩张速度的匹配。先进封装在客户认证、技术、资金和生产管理等方面存在较高门槛，短期内尚未看到产能过剩风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 26 日